

長廣 (7795 TT) Eternal Precision Mechanics

載板擴產明確，高階設備需求吃緊

買進 (初次報告)

目標價 (12 個月) : NT\$605.0

收盤價 (2026/06/26) : NT\$460.5
隱含漲幅 : 31.4%

營收組成 (2025)

單段式+預貼機 26%、兩段式 15%、三段式 48%、三段式 90 噸 11%。

本次報告更新重點

項目	本次	前次
評等	買進	--
目標價 (NT\$)	605	--
2026年營收 (NT\$/十億)	3.0	--
2026年EPS	5.3	--

交易資料表

市值	NT\$36,290百萬元
外資持股比率	9.2%
董監持股比率	62.9%
調整後每股淨值 (2026F)	NT\$23.82
負債比	32.6%
ESG評級 (Sustainalytics)	-- (曝險程度共5級)

簡明損益表 (NT\$百萬元)

年初至12月	2024A	2025A	2026F	2027F
營業收入	2,234	1,898	3,035	7,227
營業利益	564	409	802	2,569
稅後純益	299	220	417	1,361
EPS (元)	4.70	3.11	5.29	17.27
EPS YoY (%)	--	-34.0	70.2	226.7
本益比 (倍)	97.9	148.3	87.1	26.7
股價淨值比 (倍)	20.3	20.5	19.3	14.2
ROE (%)	19.2	13.8	22.2	53.2
現金殖利率 (%)	0.7%	0.5%	0.6%	1.9%
現金股利 (元)	3.00	2.15	2.64	8.64

何宗祐

bill0066@yuantan.com

王懷綺

Becky.HQ.Wang@yuantan.com

元大觀點

- ◆ 4Q26/2027 年將進入密集認列期，除因應成本上揚逐步向客戶反映設備報價，毛利率亦將受惠三段式 90 噸真空壓膜機出貨放大明顯改善。
- ◆ 載板廠往高層數 ABF 擴產，2026 年全球五大載板廠資本支出總計將飆升至 39 億美元，年增 94%，有利長廣高階設備加速認列。
- ◆ 受惠高階 ABF 載板設備需求放大、產品組合改善及設備報價提升，給予初次買進評等，以 2027 年 EPS、35 倍 PE，推得目標價 605 元。

1H26 機台認列短暫空窗期，4Q26/2027 年將進入密集認列期

1H26 機台於載板廠裝機時程尚未進入認列期使營收無法放大，估 2Q26 營收季增 9.4%至 4.6 億元。2H26 營運逐季成長，估 3Q26 營收季增 93.9%至 8.9 億元，毛利率季增 8.5ppts 至 48.9%，EPS 1.75 元，年增 310.5%，4Q26 迎來明顯營收放大動能，因應成本上揚 2026 年內將向客戶進行兩次設備價格調整，毛利率亦受惠三段式 90 噸真空壓膜機出貨動能放大明顯改善。產能方面，2026-27 年月產能將由目前 18 台提升至 20-22 台、2026 年底至 2027 年達 25-27 台，增幅約 50%，主要投入三段式 90 噸真空壓膜機。

載板廠將往高層數 ABF 擴產，有利長廣高階設備加速認列

本中心認為後續載板廠皆將往高層數 ABF 規格進行擴廠，高階設備需求將同步放大。2026 年全球五大載板廠資本支出總計將飆升至 39 億美元，年增 94%，其中台廠欣興 2026 年資本支出上修至新台幣 340 億元(70%用於 ABF)，景碩預期 ABF 設備投資額逐年遞增至 2028/29 年的 100-150 億元，海外龍頭廠 Ibiden、AT&S 擴產步調亦一致，顯示半導體先進封裝趨勢下，大廠擴產重心已告別中低階消費應用，進入高規格 ABF 載板產能軍備競賽。

受惠高階 ABF 載板設備需求放大，給予長廣初次買進評等

3-4Q26 起相關設備將陸續進入台灣載板廠裝機階段，帶動 4Q26-2027 年設備認列進入密集期，且新接訂單將逐步反映漲價後價格，營收獲利將同步放大。估 2026/27 年營收 30.4/72.3 億元，年增 59.9%/138.1%，毛利率 46.8%/52.7%，EPS 5.29/17.27 元，年增 70.2%/226.7%。晶片朝大尺寸、多層數封裝升級趨勢不變，終端客戶陸續與載板廠簽長約使需求能見度提升下，載板廠擴產態度更明確，相關高階設備商將受惠產業升級趨勢，目前高階設備交期已由原先約 5-6 個月拉長至 12-18 個月，顯示需求明顯升溫。考量長廣將受惠高階 ABF 載板設備需求放大、產品組合改善及設備報價提升，給予初次買進評等，以 2027 年 EPS、35 倍本益比，推得目標價 605 元。

長廣寡占中高階真空壓膜機市場，載板廠商皆為其客戶

長廣由長興材料(1717 TT)於 2022 年進行電子材料設備部門分割，並與 100%持有的日本子公司 Nikko-Materials 合併成立長廣精機，由於 Nikko-Materials 早期與 Intel 及 Ajinomoto 共同研發 ABF 生產設備，長廣在材料取得、參數測試上具有優勢，在載板往高層數的趨勢下，長廣單層良率可達 98-99%以上，有效控制整體 ABF 載板成品良率，因此於全球中高階真空壓膜機市占率高達 95%，客戶包含台灣、日本及韓國載板大廠。

以 2025 年營收來看，長廣營收 90%以上來自設備銷售，主要產品為真空壓膜機。壓膜機主要分為：1) 單段式模組：終端產品為中國低階消費性電子產品；2) 二段式真空壓膜機：用於筆電、伺服器 etc 4-8 層 ABF；3) 三段式模組：主要生產 10 層以上高階產品如 AI Server、車用晶片等高速傳輸相關應用；4) 最新產品 90 噸三段式真空壓膜機：主要為了因應下一代 ABF 材料所開發的機台，可以有效控制氣泡問題、減少溢膠、維持平坦度等，主要應用為 AI 晶片。2025 年產品組合為單段式+預貼機 26%、兩段式 15%、三段式 48%、三段式 90 噸 11%。

長廣營運據點包含日本、台灣、中國，日本知立廠、兒玉廠主要負責先進製程設備技術開發、設計、組裝、銷售與技服中心，行政管理等功能性單位則位於橫濱；中國廣州廠則負責預貼式/單段及二段式設備組裝、中國銷售與技服中心；台灣高雄廠目前配合日本廠組裝二段式設備。

圖 1：長廣營運據點



資料來源：公司資料、元大投顧整理

長廣聚焦技術壁壘最高、製程要求最嚴苛之載板與先進封裝的核心壓膜設備。

ABF 載板主要採用增層法(Build-up process)，其製程核心是在核心板(core substrate)兩側反覆形成介電層與銅線路。實際流程會先將 ABF 絕緣膜壓合於核心板或前一層線路表面，經固化後再以雷射鑽孔形成微盲孔，後續透過除膠渣、化學銅種子層、圖形化與電鍍銅等半加成製程(SAP/mSAP)，形成導通孔與細線路，逐層向外建構高密度互連結構。

隨著高階 AI/HPC 晶片封裝規格升級，ABF 載板已呈現面積放大、層數提高、線寬/線距縮小的趨勢，使製程對良率、翹曲控制、厚度均勻性、氣泡/空洞控制及層間平整度的要求同步提高。因此，設備端必須從前段壓合開始提升製程穩定性，而真空壓膜機正是決定 ABF 膜貼合品質、層間均勻度與平整度的關鍵設備之一。市場報導也指出，長廣針對次世代高速運算 ABF 材料開發 90 噸強壓型真空壓膜機，以因應更大晶片面積與更高層數的封裝需求。

長廣的三段式真空壓膜系統可從前段裁切、預貼與對位開始控制材料貼合品質，透過提升裁切與預貼精度，可降低 ABF 膜邊料浪費，並控制壓合過程中的溢膠(flash)，進而提升大面積面板的材料利用率與製程一致性。尤其在新世代 ABF 材料朝低介電損耗、低熱膨脹係數與高填料比例發展下，材料流動性下降、壓合難度提高，對設備的真空控制、壓力均勻性與整平能力提出更高要求。

因此，長廣 90 噸強壓型三段式真空壓膜機的價值並不只是提高壓合噸位，而是透過多段式壓合與整平設計，降低氣泡、皺褶、空洞與厚度不均等風險，並提升層間平坦度與 Z 軸厚度一致性。換言之，隨著 ABF 載板往大尺寸、高層數與細線路發展，真空壓膜設備已從單純貼合設備升級為影響高階載板良率、翹曲與製程穩定性的關鍵瓶頸設備之一。

圖 2：長廣真空壓膜機產品

種類	產品
單段式模組	 Model CV-100  Model CV-300  Manual Model V-130/V-160
二段式模組	 Pre-lack Model NT-300  Pre-lack NT-100 + Vacuum Laminator CVP-300  Model CVP-600/CVP-700
三段式模組	 Pre-lack NT-300/400 + Vacuum Laminator CVP-1600SP/CVP-1500SP(CVP-1700SP)
90 噸三段式模組	

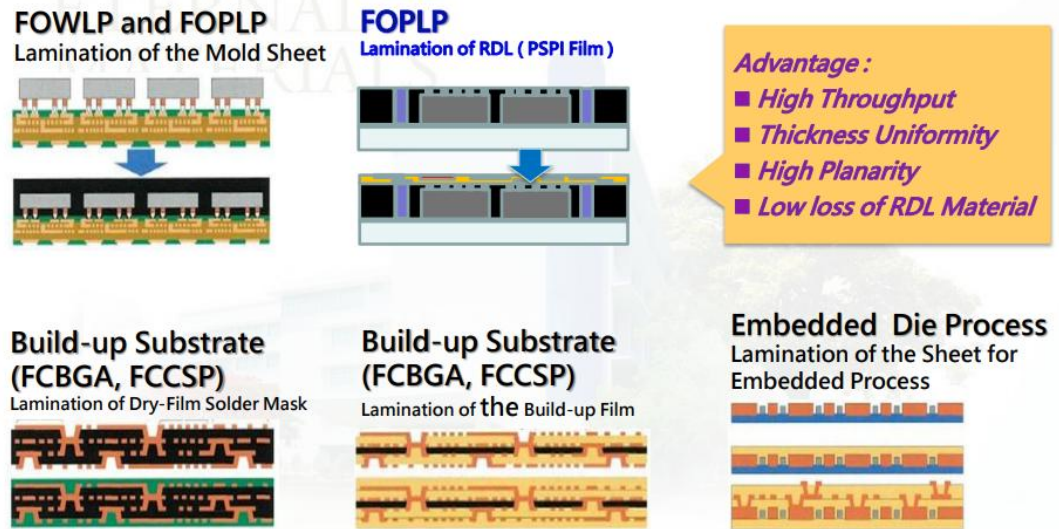
資料來源：公司資料、元大投顧整理

積極佈局半導體領域，面板級封裝、晶圓級壓膜為中長期發展趨勢

長廣近年產品終端應用逐漸從 5G、網通、車用、運算、消費性等應用跨入 AI 伺服器領域，並且在 AI 晶片之壓膜機業務取得良好進展。長廣瞄準的下一個目標市場為半導體領域，將載板真空壓膜技術運用於半導體製程上，可以提高良率、節省成本甚至縮短製程時間。先進封裝方面，未來展望投入在玻璃基板封裝領域，長廣在 2023 年已有將玻璃真空壓膜設備出貨給美國的 IDM 大廠(Intel)進行測試的經驗，目前正與面板廠合作方方形面板的真空壓膜，預期未來針對 FOPLP 相關封裝的材料將以片裝的膜材取代液態，將可以精確控制材料重量、厚度以加快速度並方便多層貼膜，因此趨勢有利於原先就在做 ABF 片狀膜材壓膜的長廣。此外，長廣也與日系材料商合作開發客製化材料的晶圓級壓膜設備，有望年底交付晶圓級真空壓膜測試機，其技術難度在於將方形膜材裁切成圓形，精確對位，並完整貼在帶有 pattern 的晶圓上，有望最快於 2027 年出貨。

圖 3：真空壓膜於半導體先進封裝之應用

● 真空壓膜機設備 Vacuum Laminator for Advanced Package

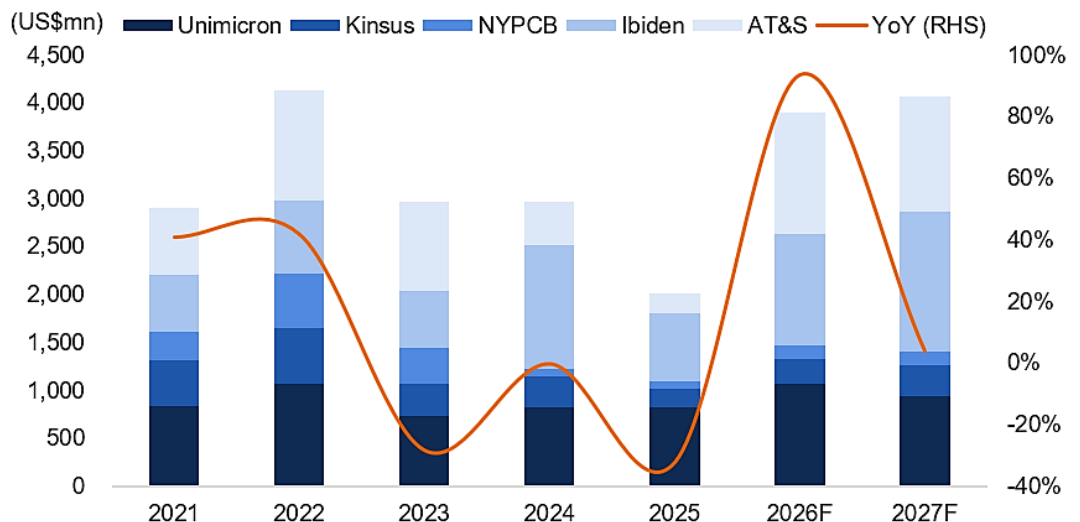


資料來源：長興材料、元大投顧整理

載板廠商將往高層數 ABF 進行擴產，有利於長廣高階設備加速認列

考量整體載板產業需求向上，本中心認為後續載板廠商皆將往高層數 ABF 規格進行擴廠，因此對於高階設備需求將同步放大。據本中心產業鏈調查，2026 年全球五大載板廠的資本支出總計將飆升至 39 億美元，年增 94%，此波投資也幾乎由高階運算需求帶動。台廠方面，龍頭欣興將 2026 年資本支出上修至新台幣 340 億元，其中高達 70% 用於 ABF 載板，且長交期設備預下單額度已拉高至 92 億元；景碩則規劃其 ABF 設備投資額將逐年遞增，2028-2029 年甚至預期落於 100-150 億元的水準。海外龍頭擴產亦步調一致，日廠 Ibiden 在 FY2026-2028 將投資 5,000 億日圓，其中 2,800 億日圓直接指名用於擴建 One 新廠(Cell8)，用以應對 AI 與 HPC 伺服器所需的高階 IC 載板產能；AT&S 在 FY2027 規畫的 4 億歐元支出中，也核心用於馬來西亞居林廠區產線建置，以滿足美系大廠 AMD 的高階客戶需求。這顯示在全球半導體先進封裝的大趨勢下，大廠的擴產重心已徹底告別中低階消費性應用，全面進入高規格 ABF 載板的產能軍備競賽。

圖 4：ABF 載板廠商資本支出金額走勢



資料來源：公司資料、Bloomberg、元大投顧整理

圖 5：ABF 載板廠商資本支出計畫

公司	資本支出展望
欣興 (3037 TT)	● 2026 年資本支出上修至新台幣 340 億元，其中約 70%用於 ABF 載板以因應重要策略客戶需求，且隨著高階設備價格持續提升，2027/2028 年資本支出至少維持 300 億元以上高位。 ● 目前董事會通過的長交期設備預下訂單額度增加至 92 億元，主要為 2027/2028 年才會交貨的設備提前下單，且考量目前經濟狀況與訂單踴躍程度，下半年董事會有望進一步上修。
景碩 (3189 TT)	● 預期 2026 年資本支出約新台幣 80 億元，其中 60 億元用於 ABF 設備投資，2027 年將提升至約 100 億元，2028/2029 年則預估落在 100-150 億元。 ● 2028-2029 年擴廠目前跟客戶洽談的方向為景碩負責廠房基礎建設，設備費用由客戶交付故不包含在前述每年約 100-150 億元的資本支出規劃。
南電 (8046 TT)	● 2026 年資本支出將以設備採購、新製程開發及現有產能去瓶頸為主，並規劃租賃母集團南部現有廠房因應需求，樹林廠新產能則將於 2H26 陸續開出。 ● 公司重心將放在生產基地與產品組合優化，預期將使整體產能增加約 5%。
Ibiden (4062 JP)	● FY2026-2028 將投入 5,000 億日圓資本支出，其中約 2,800 億日圓用於 One 新廠(Cell8)以擴建 AI/HPC 伺服器所需高階 IC 載板產能，另外約 2,200 億日圓用於現有 Gama 廠(Cell6)。 ● FY2026 資本支出約 2,000 億日圓，主要用於電子事業部門，管理層表示雖交期與人力限制使 FY2028 前擴產計畫上修較具難度，但強勁的先進 IC 載板需求確實需進一步追加投資。
AT&S (ATS AV)	● FY2027 資本支出預估約 4 億歐元，其中包含上個財年的遞延支出，主要用於馬來西亞居林廠區最後一條產線的建置爬坡以滿足 AMD 客戶需求。 ● 上述資本支出指引部分將為客戶直接預付或承擔投資費用的合作模式(LTA)，有利於相關專案初期即具備較佳的獲利率與現金流。

資料來源：公司資料、元大投顧整理

1H26 儘管進入機台認列短暫空窗期，4Q26/2027 年將進入密集認列期

長廣 1Q26 營收 4.2 億元，季減 34.2%，年減 17.4%，主因設備機台認列暫時進入空窗期，整體三段式設備認列數較 4Q25 下降，因此影響營收/獲利表現。展望後續，本中心估計 1H26 因機台於載板廠商裝機時程尚未進入營收認列期，因此營收尚無法放大，估計 2Q26 營收約 4.6 億元，季增 9.4%，年增 27.3%。進入 2H26 後，預期長廣營運將逐季成長，並於 4Q26 迎來較明顯的營收放大動能。一方面，因應整體成本上揚，公司將逐步向客戶反映設備報價，預期 2026 年內將進行兩次設備價格調整；另一方面，除報價提升外，產品組合亦將受惠三段式 90 噸真空壓膜機出貨動能放大，帶動毛利率明顯改善。

本中心估計長廣 3Q26 營收季增 93.9%至 8.9 億元，毛利率季增 8.5 個百分點至 48.9%，營業利益達 2.6 億元，季增 222.6%，年增 332.0%；稅後獲利為 1.4 億元，年增 356.9%，EPS 1.75 元。

展望 2026-2027 年，鑒於高階 ABF 載板設備需求放大，長廣將持續擴充日本產能，預計單月產能有望由目前約 18 台提升至 20-22 台，並於 2026 年底至 2027 年進一步提升至 25-27 台，整體產能增幅約達 50%。其中增加的產能將主要投入在三段式 90 噸真空壓膜機。

同時根據本中心產業鏈調查，3Q26-4Q26 起相關設備將陸續進入台灣載板廠裝機階段，帶動 4Q26-2027 年設備認列進入密集期，再加上新接訂單將逐步反映漲價後價格，預期長廣營收與獲利均有望同步放大。本中心估計 2026/2027 年營收 30.4 億元/72.3 億元，年增 59.9%/138.1%，毛利率 46.8%/52.7%，營業利益 8 億元/25.7 億元，稅後獲利 4.2 億元/13.6 億元，年增 89.4%/226.7%，EPS 5.29 元/17.27 元。

圖 6：2026 年第 1 季財報回顧、第 2 季財務預估

(百萬元)	1Q26A	季增率	年增率	2Q26F	季增率	年增率
營業收入	418	-34.2%	-17.4%	457	9.4%	27.3%
營業毛利	165	-45.3%	-23.8%	184	12.1%	7.2%
營業利益	46	-67.9%	-61.2%	81	75.7%	-7.5%
稅前純益	46	-67.4%	-62.8%	81	73.7%	-4.3%
稅後淨利	16	-79.5%	-74.4%	43	165.7%	-11.3%
調整後 EPS(元)	0.20	-81.6%	-77.0%	0.54	165.7%	-20.3%
重要比率 (%)		百分點	百分點	百分點		百分點
營業毛利率(%)	39.4%	-8.0	-3.3	40.4%	1.0	-7.6
營業利益率(%)	11.0%	-11.5	-12.4	17.7%	6.7	-6.7
稅後純益率(%)	3.9%	-8.5	-8.6	9.4%	5.5	-4.1

資料來源：公司資料、元大投顧預估

圖 7：2026 年第 3、4 季財務預估

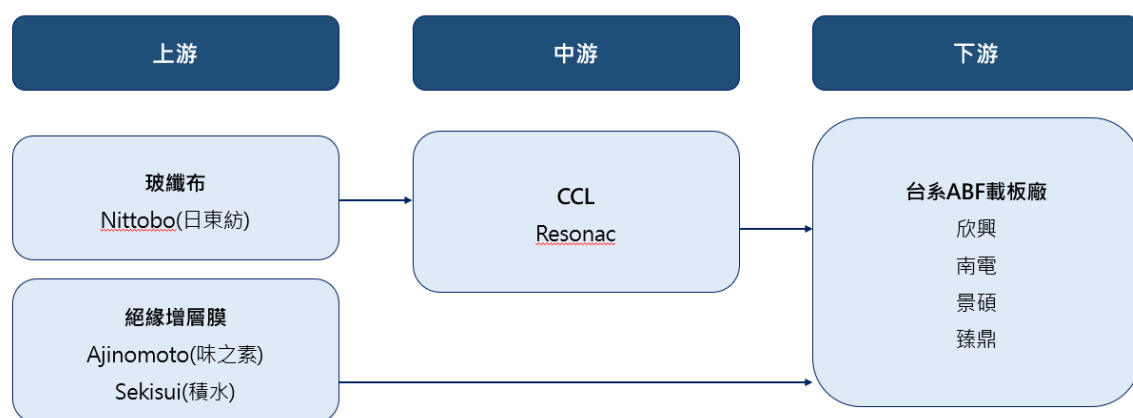
(百萬元)	3Q26F	季增率	年增率	4Q26F	季增率	年增率
營業收入	886	93.9%	122.6%	1,274	43.8%	100.7%
營業毛利	433	134.9%	168.2%	638	47.3%	112.1%
營業利益	260	222.6%	332.0%	415	59.4%	190.2%
稅前純益	260	222.6%	310.2%	415	59.4%	190.8%
稅後淨利	138	222.6%	356.9%	220	59.4%	179.6%
調整後 EPS(元)	1.75	222.6%	310.5%	2.79	59.4%	151.3%
重要比率 (%)		百分點	百分點	百分點		百分點
營業毛利率(%)	48.9%	8.5	8.3	50.1%	1.2	2.7
營業利益率(%)	29.4%	11.7	14.2	32.6%	3.2	10.0
稅後純益率(%)	15.6%	6.2	8.0	17.3%	1.7	4.9

資料來源：公司資料、元大投顧預估

中長期高階 ABF 載板價格或能進一步調升

受惠 AI 發展浪潮帶動 AI GPU、AI ASIC 等 AI 晶片需求成長，AI ABF 載板需求正向。本中心推測短期高階 AI ABF 載板因獲利水準足夠暫無調漲壓力，但中長期隨需求持續上升、載板面積增大、T-glass 供應持續吃緊，AI ABF 載板產品台系廠商後續仍有進一步議價空間。目前欣興、南電、景碩皆有耕耘高階 ABF 載板，例如欣興在美系 GPU Blackwell 市佔率預估為 30-40%，且為全球主要 AI ASIC 載板供應商；南電今年 800G 載板比重預期約 7%，包含美系、非美系等終端需求；景碩則有望成為美系 AI GPU 載板第三供。此外部分載板廠因原物料上漲等成本壓力在 2Q25、3Q25 小幅調整中低階 ABF 載板報價，本中心判斷若 T-glass 供應持續吃緊並排擠 E-glass 產能，則後續中低階 ABF 載板價格有望進一步提升。

圖 8：高階 ABF 載板供應鏈示意圖



資料來源：元大投顧整理

AI、ASIC、通用型強勢出擊，2026 年美系 CSP 資本支出估年增 86%

在 ChatGPT 等 AI 應用陸續推向市場，各大業者紛紛開始研發自有超級大模型，包括 Gemini (Google)、Claude (Anthropic)、Llama (Meta) 等，各大品牌開始大舉投入大型語言模型(LLM)市場，且每一個產品的智慧皆持續提高，部分消費者也陸續從 ChatGPT 陣營轉移至 Gemini 陣營，反映出消費者開始逐漸提升對 AI 的黏著度。根據 Grand View Research 調查，2024 年全球 AI 市場營收預估約 2,792 億美元，預估 2030 年市場規模超過 3 兆美元，擁有超過 30% 的年複合增長率。

面對這爆發性的長期成長趨勢，四大 CSP 業者(Amazon、Microsoft、Google、Meta)在法說會上一致強調，AI 投資已轉變為一項橫跨 2026 年的結構性戰略，CSP 大廠不僅持續擴大對 GB300 等次世代 AI 伺服器的採購，更將重點放在資料中心基礎設施的長期戰略規劃，以應對 AI 運算對電力及散熱系統強勁成長的需求，確保未來數年內擁有足夠的能源與容量來支持持續迭代的大模型部署。本中心認為，2026 年美國四大 CSP 資本支出將年增 86%，且將有一半的成長來自於資料中心建置，代表了資料中心的不足及未來伺服器需求。明年不僅是 NVIDIA GB300 的天下，AWS、Google、Meta ASIC 的崛起也將是一大關鍵，其中又以 Google TPU 需求最為強勁，已經有兩個客戶預計將採購 TPU。

另外，受惠於 AI 訓練與推論需求爆發的連帶效應，本中心預估 2026 年通用型伺服器出貨量將年增 23%，其中以存儲型伺服器需求最為強勁。隨著生成式 AI 應用普及和使用者數量暴增，CSP 等業者必須不斷擴充容量，且不僅限於高階 GPU 伺服器，龐大的 AI 模型訓練和推論在使用狀態中將消耗大量的數據(DATA)，使得存儲型伺服器的需求大增。

圖 9：CSP 資本支出預估

CAPEX(US\$mn)	CY 2022	CY 2023	CY 2024	CY 2025	CY 2026	CY 2027
Amazon	63,645	52,729	82,999	131,819	200,000	221,558
Meta	31,431	27,266	37,256	69,691	135,000	157,183
Microsoft	24,768	35,202	55,552	83,094	190,000	188,079
Google	31,485	32,251	52,535	91,447	185,000	218,820
Oracle	6,952	7,628	15,236	38,208	60,014	75,083
Total	158,281	155,076	243,578	414,259	770,014	860,723
YoY Growth (%)	CY 2022	CY 2023	CY 2024	CY 2025	CY 2026	CY 2027
Amazon	158.3%	17.2%	57.4%	58.8%	51.7%	10.8%
Meta	35.4%	13.3%	86.6%	87.1%	93.7%	16.4%
Microsoft	59.4%	42.1%	57.8%	49.6%	128.7%	1.0%
Google	69.0%	2.4%	62.9%	74.1%	102.3%	18.3%
Oracle	97.4%	9.7%	99.7%	150.8%	57.1%	25.1%
Total	20.8%	12.0%	57.1%	70.1%	85.9%	11.8%

資料來源：元大投顧整理

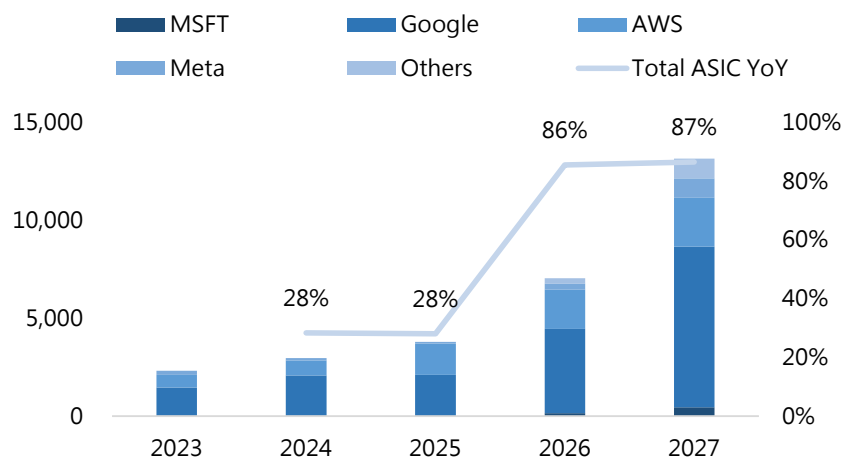
Google TPU 的崛起，ASIC 大幅度成長

根據供應鏈調查，2026 年美國三大 CSP 業者(Google、AWS、Meta)的自研 AI 晶片出貨量預計較 2025 年持續擴大。其中，Google TPU 的出貨量最為驚人，預計將貢獻 430 萬個，較去年底提升 20%，佔據 ASIC 市場的主導地位。

本中心預期，ASIC 的大規模部署將大幅拉升液冷散熱的採用比重，除了 AWS 的水冷採用比重預估在 20-30%外，Google 和 Meta 兩大 CSP 業者皆傾向於全面採用水冷散熱模式，這將直接帶動水冷供應鏈(如奇鋌、雙鴻、台達電等)的出貨量在 2026 年再次強勁成長。

在散熱材料端，Google 也在積極探討將傳統導熱介面材料(TIM2)改為使用銅片(Indium)的可能性，主要在於優化晶片與散熱模組間的熱傳導效率，目前相關設計正在認證中，顯示 CSP 業者對極致散熱解決方案的投入不斷深化。

圖 10：ASIC 晶片年產量預估

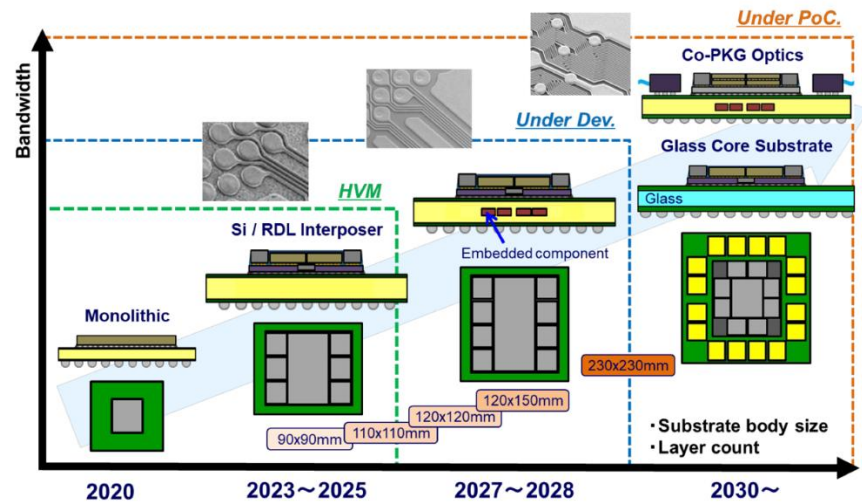


資料來源：元大投顧整理

AI 晶片面積持續擴大，將使 ABF 載板用量大增

隨著大型語言模型與生成式 AI 的算力需求快速攀升，AI 晶片的設計持續朝向更高運算密度與更大面積發展。無論是 NVIDIA、AMD 或各家大廠的新世代加速器，都呈現晶粒尺寸擴大、功耗上升、I/O 腳位數倍增的趨勢。在此背景下，ABF 載板的需求不僅以「量」擴張，更以「規格」升級為主軸。為支撐大型 GPU/AI ASIC 的高頻寬連接與多晶片架構，ABF 層數、線寬線距、孔徑控制及翹曲管理均需同步提升，帶動高端載板技術門檻不斷拉高。由於先進 AI 晶片的封裝面積更大、電源與訊號整合更複雜，單顆晶片所需 ABF 載板面積與材料用量明顯增加。整體而言，AI 晶片規模擴大正驅動 ABF 產業進入新一輪升級周期，高階需求將成為未來成長的主要動能。

圖 11：AI 晶片面積持續提升



資料來源：Ibiden、元大投顧整理

獲利調整與股票評價

給予長廣初次買進評等，目標價 605 元

根據本中心產業鏈調查，3Q26-4Q26 起相關設備將陸續進入台灣載板廠裝機階段，帶動 4Q26-2027 年設備認列進入密集期，再加上新接訂單將逐步反映漲價後價格，預期長廣營收與獲利均有望同步放大。本中心估計 2026/2027 年營收 30.4 億元/72.3 億元，年增 59.9%/138.1%，毛利率 46.8%/52.7%，營業利益 8 億元/25.7 億元，稅後獲利 4.2 億元/13.6 億元，年增 89.4%/226.7%，EPS 5.29 元/17.27 元。

綜合上述，本中心維持晶片朝大尺寸、多層數封裝升級的趨勢不變，並預期高階載板需求將持續增長，進一步帶動高階設備需求同步放大，相關設備商亦將受惠此一產業升級趨勢。且根據本中心供應鏈訪查，目前高階設備已出現交期延長現象，交期由原先約 5-6 個月拉長至 12-18 個月，顯示設備需求明顯升溫。此外，終端客戶已陸續與載板廠商簽訂長期合約，以確保未來高階載板產能；在需求能見度提升下，載板廠商擴產態度將更為明確，亦有助於設備商取得訂金並加速訂單認列。

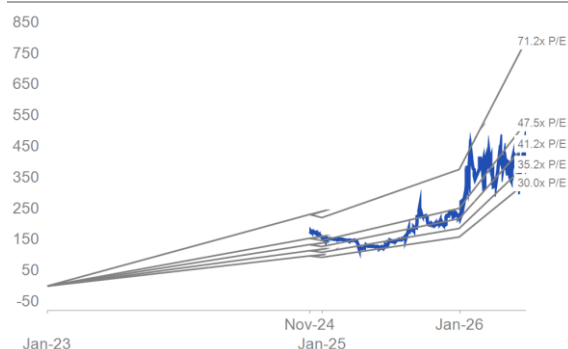
評價方面，觀察相關同業歷史本益比約落在 15-60 倍，長廣歷史合理本益比約為 25-60 倍。考量長廣將受惠高階 ABF 載板設備需求放大、產品組合改善及設備報價提升，本中心給予長廣 35 倍本益比，並以 2027 年 EPS 推估目標價為 605 元，給予長廣初次「買進」評等。

圖 12：2026、2027 年財務預估

(百萬元)	2026F	年增率	2027F	年增率
營業收入	3,035	59.9%	7,227	138.1%
營業毛利	1,420	67.0%	3,812	168.5%
營業利益	802	96.1%	2,569	220.4%
稅前純益	802	93.1%	2,569	220.2%
稅後淨利	417	89.4%	1,361	226.7%
調整後 EPS(元)	5.29	70.2%	17.27	226.7%
重要比率 (%)		百分點	百分點	
營業毛利率(%)	46.8%	2.0	52.7%	6.0
營業利益率(%)	26.4%	4.9	35.5%	9.1
稅後純益率(%)	13.7%	2.1	18.8%	5.1

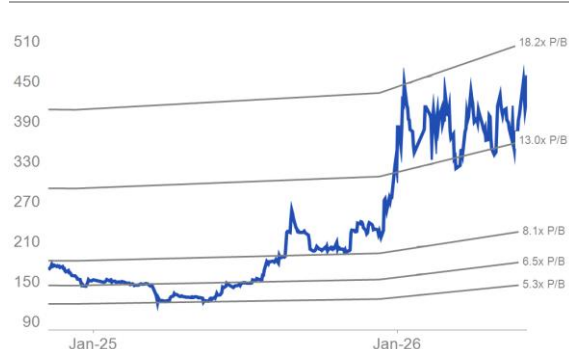
資料來源：公司資料、元大投顧預估

圖 13：12 個月預期本益比區間圖



資料來源：公司資料、元大投顧、CMoney

圖 14：12 個月預期股價淨值比區間圖



資料來源：公司資料、元大投顧、CMoney

圖 15：同業評價比較表

公司	代碼	評等	股價	市值 (百萬美元)	調整後每股盈餘			本益比(倍)			調整後每股盈餘成長率(%)		
					2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
長廣	7795 TT	買進	460.5	1,134	3.11	5.29	17.27	148.3	87.1	26.7	(34.0)	70.2	226.7
國外同業													
Applied Materials	AMAT US	未評等	668.0	530,365	8.7	12.3	16.4	76.8	54.5	40.7	0.3	40.8	34.1
LAM Research	LRCX US	未評等	401.8	502,504	4.2	5.7	8.0	96.5	70.7	50.5	43.0	36.5	39.9
Tokyo Electron	8035 JP	未評等	72140.0	217,974	1182.4	1194.9	1568.2	61.0	60.4	46.0	50.9	1.1	31.2
BE Semiconductor	BESI NA	未評等	289.1	26,643	1.7	4.0	6.3	173.8	72.3	46.0	(27.9)	140.4	57.0
Shibaura	6590 JP	未評等	4395.0	2,084	157.5	177.3	229.6	27.9	24.8	19.1	18.2	12.5	29.5
ASMPT	0522 HK	未評等	194.1	10,956	2.6	3.8	5.7	74.5	51.2	34.0	267.1	45.6	50.5
SUSS MicroTec	SMHN GR	未評等	97.6	2,120	2.6	2.0	3.5	37.7	49.0	28.2	(4.2)	(23.2)	74.1
國外同業平均					194.2	200.0	262.5	78.3	54.7	37.8	49.6	36.2	45.2

資料來源：公司資料、元大投顧、Reuters；每股盈餘數字以當地貨幣為單位；股價依首頁收盤價日期為準。

圖 16：同業評價比較表 (續)

公司	代碼	評等	股價	市值 (百萬美元)	股東權益報酬率(%)			每股淨值			股價淨值比(倍)		
					2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
長廣	7795 TT	買進	460.5	1,134	13.8	22.2	53.2	22.44	23.82	32.45	20.5	19.3	14.2
國外同業													
Applied Materials	AMAT US	未評等	668.0	530,365	38.6	40.5	43.2	25.4	33.2	40.8	26.3	20.1	16.4
LAM Research	LRCX US	未評等	401.8	502,504	57.9	66.1	71.8	7.7	9.2	13.9	52.4	43.7	28.9
Tokyo Electron	8035 JP	未評等	72140.0	217,974	34.9	26.9	33.1	4031.4	4604.9	5349.5	17.9	15.7	13.5
BE Semiconductor	BESI NA	未評等	289.1	26,643	28.7	61.5	69.6	5.3	7.2	10.0	54.9	40.3	29.0
Shibaura	6590 JP	未評等	4395.0	2,084	24.0	21.1	22.9	721.8	845.3	1022.5	6.1	5.2	4.3
ASMPT	0522 HK	未評等	194.1	10,956	3.1	9.4	12.4	40.9	46.7	47.9	4.8	4.2	4.1
SUSS MicroTec	SMHN GR	未評等	97.6	2,120	15.5	11.4	16.3	16.5	18.8	21.5	5.9	5.2	4.5
國外同業平均					29.0	33.8	38.5	692.7	795.0	929.4	24.0	19.2	14.4

資料來源：公司資料、元大投顧、Reuters；每股淨值數字以當地貨幣為單位；股價依首頁收盤價日期為準。

圖 17：季度及年度簡明損益表 (合併)

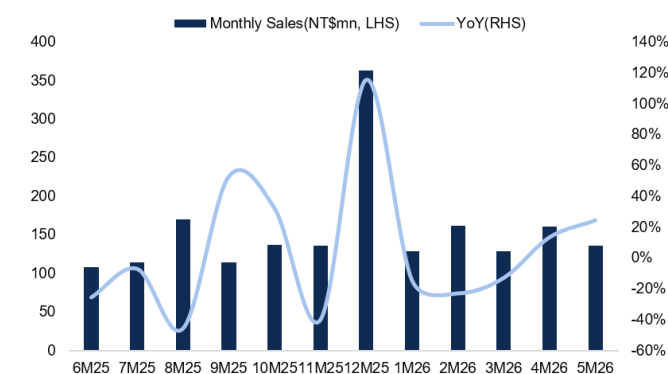
(NT\$百萬元)	1Q2026A	2Q2026F	3Q2026F	4Q2026F	1Q2027F	2Q2027F	3Q2027F	4Q2027F	FY2026F	FY2027F
營業收入	418	457	886	1,274	1,336	1,633	1,872	2,386	3,035	7,227
銷貨成本	(253)	(273)	(453)	(636)	(643)	(780)	(882)	(1,110)	(1,615)	(3,415)
營業毛利	165	184	433	638	693	853	990	1,276	1,420	3,812
營業費用	(119)	(104)	(173)	(223)	(237)	(281)	(317)	(409)	(618)	(1,244)
營業利益	46	81	260	415	457	572	673	867	802	2,569
業外利益	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稅前純益	46	81	260	415	457	572	673	867	802	2,569
所得稅費用	(30)	(38)	(122)	(195)	(215)	(269)	(316)	(407)	(386)	(1,207)
少數股東權益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歸屬母公司稅後純益	16	43	138	220	242	303	357	459	417	1,361
調整後每股盈餘(NT\$)	0.20	0.54	1.75	2.79	3.07	3.85	4.52	5.83	5.29	17.27
調整後加權平均股數(百萬股)	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
重要比率										
營業毛利率	39.4%	40.4%	48.9%	50.1%	51.9%	52.3%	52.9%	53.5%	46.8%	52.7%
營業利益率	11.0%	17.7%	29.4%	32.6%	34.2%	35.1%	35.9%	36.3%	26.4%	35.5%
稅前純益率	11.1%	17.7%	29.4%	32.6%	34.2%	35.1%	35.9%	36.3%	26.4%	35.5%
稅後純益率	3.9%	9.4%	15.6%	17.3%	18.1%	18.6%	19.0%	19.3%	13.7%	18.8%
有效所得稅率	65.3%	46.9%	46.9%	47.0%	47.0%	47.0%	47.0%	46.9%	48.1%	47.0%
季增率(%)										
營業收入	-34.2%	9.4%	93.9%	43.8%	4.9%	22.2%	14.6%	27.4%		
營業利益	-67.9%	75.7%	222.6%	59.4%	10.1%	25.3%	17.5%	28.9%		
稅後純益	-79.5%	165.7%	222.6%	59.4%	10.1%	25.3%	17.5%	28.9%		
調整後每股盈餘	-81.6%	165.7%	222.6%	59.4%	10.1%	25.3%	17.5%	28.9%		
年增率(%)										
營業收入	-17.4%	27.3%	122.6%	100.7%	219.9%	257.3%	111.3%	87.2%	59.9%	138.1%
營業利益	-61.2%	-7.5%	332.0%	190.2%	894.6%	609.3%	158.4%	109.0%	96.1%	220.4%
稅後純益	-74.4%	-11.3%	356.9%	179.6%	1403.8%	609.3%	158.4%	109.0%	89.4%	226.7%
調整後每股盈餘	-77.0%	-20.3%	310.5%	151.3%	1403.8%	609.3%	158.4%	109.0%	70.2%	226.7%

資料來源：公司資料、元大投顧、CMoney；標“A”為歷史數據；調整後每股盈餘為根據調整後加權平均股數計算。

公司簡介

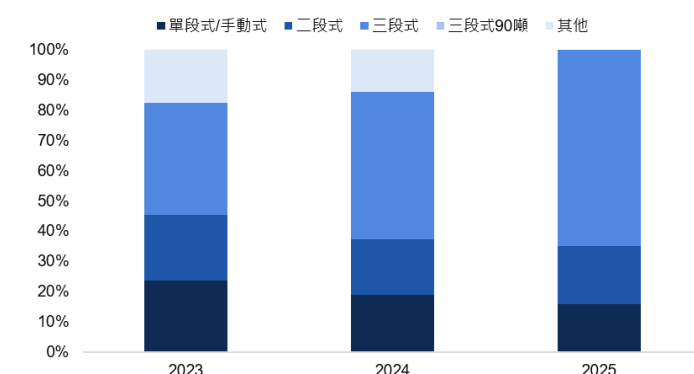
長廣由長興材料(1717 TT)於 2022 年進行電子材料設備部門分割，並與 100%持有的日本子公司 Nikko-Materials 合併成立長廣精機，營運據點包含日本、台灣、中國，客戶包含台灣、日本及韓國載板大廠。由於 Nikko-Materials 早期與 Intel 及 Ajinomoto 共同研發 ABF 生產設備，長廣在材料取得、參數測試上具有優勢，故於全球中高階真空壓膜機市占率高達 95%，營收 90%以上來自真空壓膜機設備銷售，主要產品包括用於低階 PCB 製程的單段設備、用於多層 ABF 的二段、三段設備。

圖 18：月營收



資料來源：公司資料、元大投顧整理

圖 19：營收組成



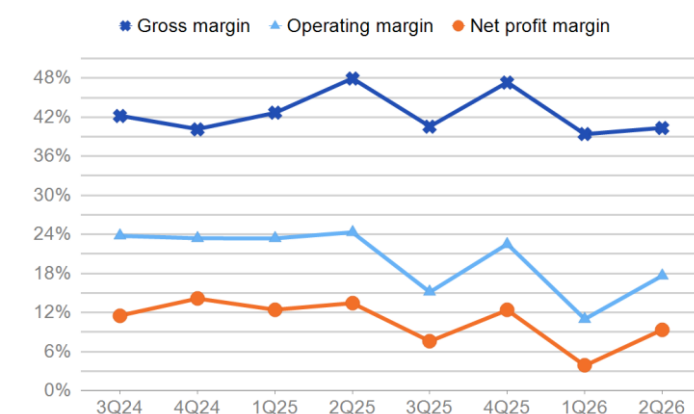
資料來源：公司資料、元大投顧整理

圖 20：營收趨勢



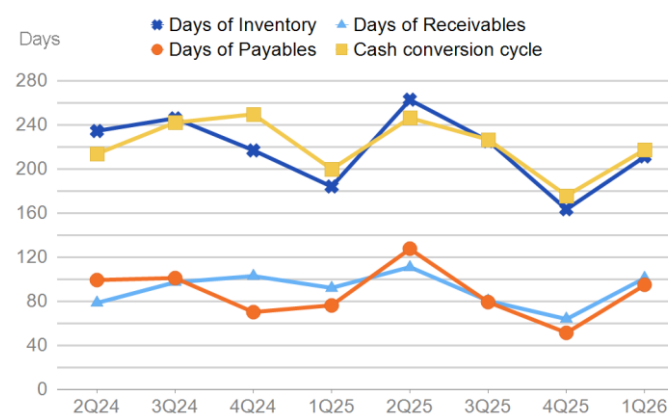
資料來源：CMoney、公司資料

圖 21：毛利率、營益率、淨利率



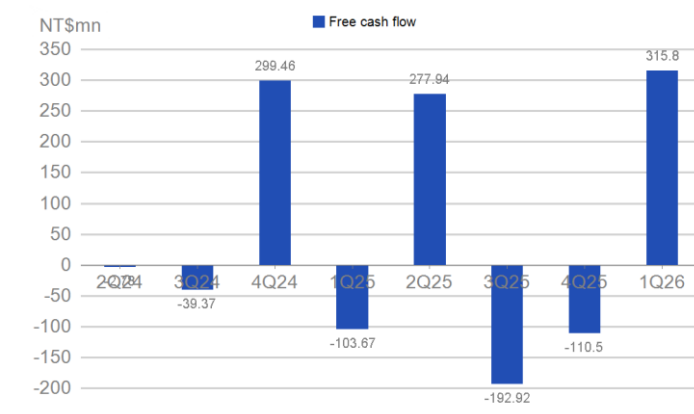
資料來源：CMoney、公司資料

圖 22：經營能力



資料來源：CMoney、公司資料

圖 23：自由現金流量



資料來源：CMoney、公司資料

資產負債表

年初至 12 月 (NT\$ 百萬元)	2023A	2024A	2025A	2026F	2027F
現金與短期投資	1,860	1,718	1,132	1,161	1,040
存貨	1,022	634	566	673	1,386
應收帳款及票據	446	452	460	787	1,185
其他流動資產	146	76	110	110	110
流動資產	3,474	2,881	2,268	2,731	3,721
採用權益法之投資	0	0	0	0	0
固定資產	122	113	130	135	712
無形資產	33	32	31	30	30
其他非流動資產	235	177	154	154	154
非流動資產	390	322	314	319	896
資產總額	3,863	3,203	2,582	3,050	4,617
應付帳款及票據	66	45	49	128	714
短期借款	150	0	284	284	284
什項負債	1,160	1,256	367	367	367
流動負債	1,376	1,301	700	779	1,365
長期借款	671	0	0	100	400
其他負債及準備	316	295	293	293	293
長期負債	987	295	293	393	693
負債總額	2,363	1,596	993	1,173	2,058
股本	616	708	708	788	788
資本公積	812	813	601	601	601
保留盈餘	401	453	674	882	1,563
什項權益	-328	-367	-394	-394	-394
歸屬母公司之權益	1,500	1,607	1,589	1,877	2,558
非控制權益	0	0	0	0	0
股東權益總額	1,500	1,607	1,589	1,877	2,558

資料來源：公司資料、元大投顧

現金流量表

年初至 12 月 (NT\$ 百萬元)	2023A	2024A	2025A	2026F	2027F
本期純益	296	299	220	417	1,361
折舊及攤提	76	76	74	20	23
本期營運資金變動	50	312	46	-355	-525
其他營業資產 及負債變動	207	-103	-433	0	0
營運活動之現金流量	628	583	-93	82	860
資本支出	-30	-10	-36	-600	-600
本期長期投資變動	0	0	0	0	0
其他資產變動	135	0	0	0	0
投資活動之現金流量	105	-10	-36	-25	-600
股本變動	95.6	92.69	0	0	0
本期負債變動	-154	-447	-183	100	300
現金增減資	510	0	0	80	0
支付現金股利	-180	-154	-212	-208	-681
其他調整數	-89	-150	-62	0	0
融資活動之現金流量	182	-658	-457	-28	-381
匯率影響數	-124	-57	0	0	0
本期產生現金流量	791	-142	-586	29	-121
自由現金流量	598	573	-129	57	260

資料來源：公司資料、元大投顧

損益表

年初至 12 月 (NT\$ 百萬元)	2023A	2024A	2025A	2026F	2027F
營業收入	2,361	2,234	1,898	3,035	7,227
銷貨成本	(1,303)	(1,238)	(1,048)	(1,615)	(3,415)
營業毛利	1,058	996	850	1,420	3,812
營業費用	(500)	(432)	(441)	(618)	(1,244)
推銷費用	(315)	(193)	(205)	(287)	(635)
研究費用	(31)	(12)	(28)	(47)	(91)
管理費用	(164)	(216)	(218)	(287)	(517)
其他費用	9	(12)	9	2	0
營業利益	558	564	409	802	2,569
利息收入	1	3	4	2	0
利息費用	(16)	(12)	0	0	0
利息收入淨額	(15)	(9)	4	2	0
投資利益(損失)淨額	0	0	0	0	0
匯兌損益	(6)	(1)	0	0	0
其他業外收入(支出)淨額	13	6	3	(1)	0
稅前純益	550	560	416	802	2,569
所得稅費用	(254)	(261)	(196)	(386)	(1,207)
少數股權淨利	0	0	0	0	0
歸屬母公司之稅後純益	296	299	220	417	1,361
稅前息前折舊攤銷前淨利	641	647	499	802	2,569
調整後每股盈餘 (NT\$)	0	4.70	3.11	5.29	17.27

資料來源：公司資料、元大投顧

主要財務報表分析

年初至 12 月	2023A	2024A	2025A	2026F	2027F
年成長率 (%)					
營業收入	(39.1)	(5.4)	(15.0)	59.9	138.1
營業利益	(56.2)	1.1	(27.5)	96.1	220.4
稅前息前折舊攤銷前淨利	(53.5)	0.9	(22.9)	60.8	220.3
稅後純益	(67.2)	1.1	(26.4)	89.4	226.7
調整後每股盈餘	(100.0)	--	(34.0)	70.2	226.7
獲利能力分析 (%)					
營業毛利率	44.8	44.6	44.8	46.8	52.7
營業利益率	23.6	25.2	21.5	26.4	35.5
稅前息前淨利率	22.6	24.5	21.9	26.4	35.5
稅前息前折舊攤銷前淨利率	27.2	29.0	26.3	26.4	35.5
稅前純益率	23.3	25.1	21.9	26.4	35.5
稅後純益率	12.5	13.4	11.6	13.7	18.8
資產報酬率	8.1	8.5	7.6	13.7	29.5
股東權益報酬率	25.1	19.2	13.8	22.2	53.2
穩定/償債能力分析					
負債權益比 (%)	157.5	99.3	62.5	62.5	80.5
淨負債權益比(%)	-69.3	-106.9	-53.4	-41.4	-13.9
利息保障倍數 (倍)	35.9	47.9	0.0		
流動比率 (%)	252.5	221.4	324.0	350.4	272.6
速動比率 (%)	176.8	171.4	240.6	264.1	171.1
淨負債 (NT\$百萬元)	-1,039	-1,718	-848	-777	-356
調整後每股淨值 (NT\$)	24.40	22.70	22.44	23.82	32.45
評價指標 (倍)					
本益比	--	97.9	148.3	87.1	26.7
股價自由現金流量比	60.7	63.4	--	635.0	139.6
股價淨值比	18.9	20.3	20.5	19.3	14.2
股價稅前息前折舊攤銷前淨	56.6	56.1	72.8	45.3	14.1
股價營收比	15.4	16.3	19.1	12.0	5.0

資料來源：公司資料、元大投顧；註：負債為短期債加上長期債。

附錄：重要揭露事項

分析師聲明

主要負責撰寫本研究報告全文或部分內容之分析師，茲針對本報告所載證券或證券發行機構，於此聲明：(1) 文中所述觀點皆準確反映其個人對各證券或證券發行機構之看法；(2) 研究部分分析師於本研究報告中所提出之特定投資建議或觀點，與其過去、現在、未來薪酬的任何部份皆無直接或間接關聯。

長廣 (7795 TT)- 投資建議與目標價三年歷史趨勢



資料來源：CMoney、元大投顧

投資評等說明

買進：根據本中心對該檔個股投資期間絕對或相對報酬率之預測，我們對該股持正面觀點。此一觀點係基於本中心對該股之發展前景、財務表現、利多題材、評價資訊以及風險概況之分析。建議投資人於投資部位中增持該股。

持有-超越同業：本中心認為根據目前股價，該檔個股基本面吸引力高於同業。此一觀點係基於本中心對該股發展前景、財務表現、利多題材、評價資訊以及風險概況之分析。

持有-落後同業：本中心認為根據目前股價，該檔個股基本面吸引力低於同業。此一觀點係基於本中心對該股發展前景、財務表現、利多題材、評價資訊以及風險概況之分析。

賣出：根據本中心對該檔個股投資期間絕對或相對報酬率之預測，我們對該股持負面觀點。此一觀點係基於本中心對該股之發展前景、財務表現、利多題材、評價資訊以及風險概況之分析。建議投資人於投資部位中減持該股。

評估中：本中心之預估、評等、目標價尚在評估中，但仍積極追蹤該個股。

限制評等：為遵循相關法令規章及/或元大之政策，暫不給予評等及目標價。

註：元大給予個股之目標價係依 12 個月投資期間計算。大中華探索系列報告並無正式之 12 個月目標價，其投資建議乃根據分析師報告中之指定期間分析而得。

總聲明

© 2026 元大版權所有。本報告之內容取材自本公司認可之資料來源，但並不保證其完整性或正確性。報告內容並非任何證券之銷售要約或邀購。報告中所有的意見及預估，皆基於本公司於特定日期所做之判斷，如有變更恕不另行通知。

本報告僅提供一般資訊，文中所載資訊或任何意見，並不構成任何買賣證券或其他投資標的之要約或要約之引誘。報告資料之刊發僅供客戶一般傳閱用途，並非意欲提供專屬之投資建議，亦無考慮任何可能收取本報告之人士的個別財務狀況與目標。對於投資本報告所討論或建議之任何證券、投資標的，或文中所討論或建議之投資策略，投資人應就其是否適合本身而諮詢財務顧問的意見。本報告之內容取材自據信為可靠之資料來源，但概不以明示或默示的方式，對資料之準確性、完整性或正確性作出任何陳述或保證。本報告並非(且不應解釋為)在任何司法管轄區內，任何非依法從事證券經紀或交易之人士或公司，為該管轄區內從事證券經紀或交易之遊說。

元大研究報告於美國僅發送予美國主要投資法人(依據 1934 年《證券交易法》15a-6 號規則及其修正條文與美國證券交易委員會詮釋定義)。美國投資人若欲進行與本報告所載證券相關之交易，皆必須透過依照 1934 年《證券交易法》第 15 條及其修正條文登記註冊之券商為之。元大研究報告在台灣由元大證券投資顧問股份有限公司發佈，在香港則由元大證券(香港)有限公司發佈。元大證券(香港)係獲香港證券及期貨事務監察委員會核准註冊之券商，並獲許

從事受規管活動，包括第 4 類規管活動(就證券提供意見)。非經元大證券(香港)有限公司書面明示同意，本研究報告全文或部份，不得以任何形式或方式轉載、轉寄或揭露。

欲取得任何本報告所載證券詳細資料之台灣人士，應透過下列方式聯絡元大證券投資顧問股份有限公司：

致：聯絡人姓名

元大證券投資顧問股份有限公司

台灣臺北市 106 仁愛路三段 157 號 4 樓

Copyright © 2026 Sustainalytics, a Morningstar company. All rights reserved. The information, data, analyses and opinions contained herein: (1) includes the proprietary information of Sustainalytics and/or its content providers; (2) may not be copied or redistributed except as specifically authorized; (3) do not constitute investment advice nor an endorsement of any product, project, investment strategy or consideration of any particular environmental, social or governance related issues as part of any investment strategy; (4) are provided solely for informational purposes; and (5) are not warranted to be complete, accurate or timely. The ESG-related information, methodologies, tools, ratings, data and opinions contained or reflected herein are not directed to or intended for use or distribution to India-based clients or users and their distribution to Indian resident individuals or entities is not permitted. Neither Morningstar Inc., Sustainalytics, Morningstar Asia Ltd. Taiwan Branch nor their content providers accept any liability for the use of the information, for actions of third parties in respect to the information, nor are responsible for any trading decisions, damages or other losses related to the information or its use. The use of the data is subject to conditions available at <https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers>.